



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

*Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione*

*Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione*

AI DIRETTORI DEGLI UFFICI  
SCOLASTICI REGIONALI

LORO SEDI

AI DIRIGENTI PREPOSTI DEGLI  
UFFICI SCOLASTICI REGIONALI

LORO SEDI

OGGETTO: Concorso *“YouPack... Imballaggio sostenibile del futuro? Non chiederlo a noi, inventalo tu”* rivolto agli studenti degli Istituti Tecnici e Professionali – settore grafica.

Nell'ambito delle iniziative previste dal Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 27.04.2015 tra MIUR e ENIPG (Ente Nazionale Istruzione Professionale Grafica) è bandito il concorso *“YouPack... Imballaggio sostenibile del futuro? Non chiederlo a noi, inventalo tu”* rivolto agli studenti che frequentano il 3° e 4° anno dell'indirizzo “Grafica e Comunicazione” degli Istituti Tecnici Statali e Paritari e il 3° e 4° anno degli Istituti Professionali che erogano percorsi afferenti al settore grafico.

Il Protocollo d'intesa si propone di rafforzare il raccordo tra scuola e mondo del lavoro anche con specifiche attività, in collaborazione con associazioni e imprese del settore di riferimento, volte a favorire lo sviluppo delle competenze degli studenti e a potenziare le attività di tipo laboratoriale.

Ciò premesso, nel trasmettere in allegato il Regolamento del Concorso e il modulo di adesione, si invitano le SS.LL. a diffondere l'iniziativa presso le scuole del territorio interessate, statali e paritarie, sensibilizzando le stesse alla partecipazione.

Con l'occasione si segnala che il termine per l'invio della scheda di adesione è prorogato al **12 febbraio 2018**.

Si confida nella consueta collaborazione delle SS.LL..

IL DIRETTORE GENERALE  
Maria Assunta Palermo